



康迈微国产替代表贴耦合器

产品特点:

替代 Mini-Circuits 全系列磁芯绕线耦合器,替代 IPP、Anaren 表贴耦合器,现货供应,原位替代,全国产化,质量等级覆盖工业级和普军级;替代 Werlatone 大功率磁芯绕线耦合器,功率 2000W 以内都可以替代,大功率器件是按需定制。

康迈微的产品都在官网上,每周都有新产品上线,最新产品及最新规格书请到官网下载,官网www.com-mw.com (一万多单品),现货商城www.dianzibuy.com 真实现货(一千多单品),明码标价,诚信经营。









货架产品目录:

			起始频	终止频			耦合度	功率容	
序号	名称	型号	率(MHz)	率(MHz)	替代品牌	替代型 号	(dB)	量(₩)	页码
1	耦合器	C0154	0	6000	Mini-Circuits	RBDC-20-63+	20	0. 5	3
2	耦合器	C0205	1.5	60	Mini-Circuits	SYDC-20-61VHP+	20	40	4
3	耦合器	C0007	5	1000	Mini-Circuits	ADC-10-4+	10	1	5
4	耦合器	C0059	5	1000	Mini-Circuits	DBTC-10-13+	10.3	1	6
5	耦合器	C0011	5	1000	Mini-Circuits	ADC-15-4+	15	1	7
6	耦合器	C0019	5	1000	Mini-Circuits	ADC-20-4+	20	2	8
7	耦合器	ZDC9-15L10-512-1428	10	512			15	1	9
8	耦合器	C0206	10	512	Mini-Circuits	SYDC-20-62HP+	25	25	10
9	耦合器	ZDC9-20L10-678-1432	10	678			20	25	11
10	耦合器	C0043	10	1500	Mini-Circuits	DBTC-7-152+	7	2	12
11	耦合器	C0398	20	678	IPP	IPP-8044	50	300	13
12	耦合器	C0399	20	1000	IPP	IPP-8070	50	150	14
13	耦合器	ZDC9-20L30-2000-1347	30	2000			20	2	15
14	耦合器	C0083	50	2000	Mini-Circuits	DBTC-17-5+	17	2	16
15	耦合器	C0022	100	1200	Mini-Circuits	ADC-20-12+	20	1	17
16	耦合器	ZDC9-40M200-1000-1552	200	1000			40	300	18
17	耦合器	C0406	225	1850	IPP	IPP-8059	35	100	19
18	耦合器	C0408	225	2500	IPP	IPP-8063	45	200	20





序号	名称	型号	起始频率 (MHz)	终止频率 (MHz)	替代品牌	替代型号	耦合度 (dB)	功率容 量(W)	页码
19	耦合器	C0410	500	2500	IPP	PP-8057	33	150	21
20	耦合器	C0412	500	3000	IPP	IPP-8090	32	200	22
21	耦合器	C1049	800	1000			10	250	23
22	耦合器	C1048	800	1000	ANAREN	XC0900A-20S	20	150	24
23	耦合器	C1098	800	3000	Mini-Circuits	BDCH-25-33+	25	150	25
24	耦合器	C1045	1700	2000	ANAREN	XC1900A-10S	10	175	26
25	耦合器	C1044	1700	2000	ANAREN	XC1900A-20S	20	150	27
26	耦合器	C1040	2000	2300	ANAREN	XC2500E-10S	10	165	28
27	耦合器	C1041	2000	2300	ANAREN	XC2100A-30S	30	120	29
28	耦合器	C1039	2300	2700	ANAREN	XC2500E-10S	10	145	30
29	耦合器	C1038	2300	2700	ANAREN	XC2500P-20S	20	56	31
30	耦合器	C1062	2300	3800	ANAREN	X3C30F1-20S	20	25	32
31	耦合器	C1037	3300	3800	ANAREN	XC3500M-20S	20	80	33



DC~6GHz, 耦合度20dB, 微带半圆孔, 0.5W, 工业级, 替代RBDC-20-63+

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	6	GHz
插入损耗			1.6	dB
耦合度	17	20	23	dB
主线驻波比			1.5	

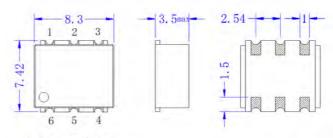
其它参数

接口形式	微带半圆孔
功率容量	0.5W
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-55~+100℃设计保证
质量等级	工业级
其它	替代RBDC-20-63+

端口定义

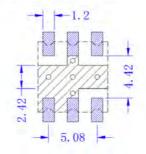
输入端口	3
输出端口	4
耦合端口	1
接地端口	2,5,6

外形结构图 (mm)



Tolerance: ± 0 . 3mm

Suggested PCB Layout



注意事项

1	清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持220℃回流焊。

1.5~60MHz, 耦合度20dB, 微带半圆孔, 40W, 工业级, 替代SYDC-20-61VHP+

产品特点

高功率,低损耗。

技术要求

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1.5	~	60	MHz
插入损耗		0.1	0.2	dB
耦合度	20.5	20	21.6	dB
方向性	16	22		dB
主线驻波比		1.15	1.25	
耦合线驻波比		1.2	1.3	

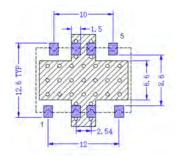
其它参数

接口形式	微带半圆孔
功率容量	40W
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-55~+100℃设计保证
质量等级	工业级
其它	替代SYDC-20-61VHP+

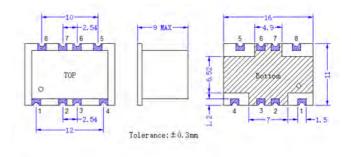
其它参数

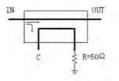
输入端口	1
输出端口	8
耦合端口	4
隔离端口	5 (接50欧姆负载电阻)
接地端口	2,3,6,7

建议PCB布局图



外形结构图 (mm)





其它参数

1	清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持220℃回流焊。

拟制: 0001 22-03-07 审核: 0001 22-03-07 客户: 版本: 220609V2

注:本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试;由于产品升级迭代,对与本页内容的任何变更恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。



5~1000MHz, 耦合度10dB, 微带半圆孔, 1W, 工业级, 替代ADC-10-4+

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	5	~	1000	MHz
插入损耗		1.1	1.5	dB
耦合度	9.5	10	10.5	dB
方向性	13	17		dB
主线驻波比		1.2	1.3	
耦合线驻波比		1.2	1.3	

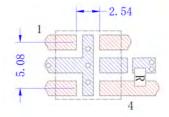
其它参数

接口形式	微带半圆孔
阻抗	50Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-55~+100℃设计保证
质量等级	工业级
其它	替代ADC-10-4+

端口定义

输入端口	1
输出端口	6
耦合端口	3
隔离端口	4 (外接50Ω负载)

建议PCB布局图



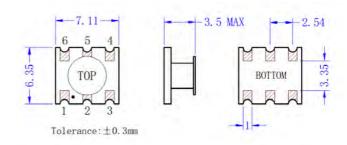
典型测试数据

F(MHz)	S12 IL	S23 ISO	S11 VSW R	S33 VSW R	S13 C
5	-0.84	-31.1	1.04	1.16	-9.37
100	-0.94	-30.7	1.02	1.11	-9.81
200	-0.97	-30.1	1.03	1.17	-9.83
400	-0.99	-29.3	1.05	1.17	-9.93
600	-1.01	-28.1	1.07	1.17	-9.78
700	-1.02	-27.5	1.07	1.16	-9.76
800	-1.03	-27.1	1.09	1.17	-9.74
900	-1.04	-26.3	1.09	1.16	-9.66
1000	-1.07	-25.6	1.09	1.16	-9.57

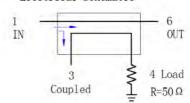
参考实物图



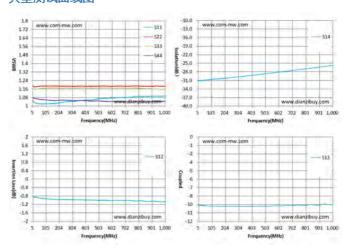
外形结构图 (mm)



Electrical Schematic



典型测试曲线图



注意事项

1	清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持260℃回流焊。

拟制: 0001 22-06-14 审核: 0001 22-06-14 客户: 版本: 220614V2



5~1000MHz, 耦合度10.3dB, 微带半圆孔, 1W, 工业级, 代替DBTC-10-13+

产品特点

宽带,小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	5	~	1000	MHz
插入损耗		1.6	2	dB
耦合度	9.8	10.3	10.8	dB
方向性	10	18		dB
主线驻波比		1.3		
耦合线驻波比		1.3		

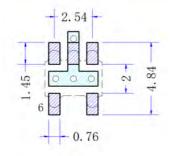
其它参数

接口形式	微带半圆孔
阻抗	50Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85°C
存储温度	-55~+100°C
质量等级	工业级
其它	代替DBTC-10-13+

端口定义

输入端口	3	
输出端口	4	
耦合端口	1	
隔离端口	6 (不使用)	
接地端口	2	

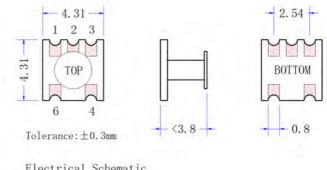
建议PCB布局图



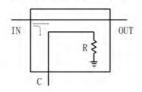
参考实物图



外形结构图 (mm)



Electrical Schematic



注意事项

1	清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持260℃回流焊。

拟制: 0001 22-05-09 审核: 0001 22-05-09 客户: 版本: 220529V1



5~1000MHz, 耦合度15dB, 微带半圆孔, 1W, 工业级, 替代ADC-15-4+

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	5	~	1000	MHz
插入损耗		0.9	1.2	dB
耦合度	14	15	15.5	dB
方向性	15	20		dB
主线驻波比		1.2	1.3	
耦合线驻波比		1.2	1.3	

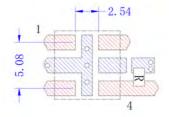
其它参数

接口形式	微带半圆孔
阻抗	50Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-55~+100℃设计保证
质量等级	工业级
其它	替代ADC-15-4+

端口定义

输入端口	1
输出端口	6
耦合端口	3
隔离端口	4 (外接50Ω负载)

建议PCB布局图



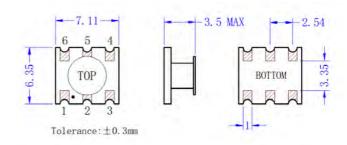
典型测试数据

F(MHz)	S12 IL	S23 ISO	S11 VSW R	S33 VSW R	S13 C
5	-0.64	-43.1	1.08	1.12	-14.3
100	-0.76	-42.6	1.09	1.15	-14.5
200	-0.77	-42.2	1.09	1.15	-14.6
400	-0.8	-41.5	1.1	1.16	-14.7
600	-0.83	-40.1	1.12	1.17	-14.8
700	-0.81	-39.2	1.13	1.18	-14.8
800	-0.83	-38.2	1.15	1.2	-14.9
900	-0.83	-37.2	1.17	1.21	-14.9
1000	-0.84	-36.1	1.19	1.23	-14.9

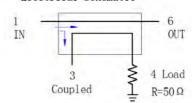
参考实物图



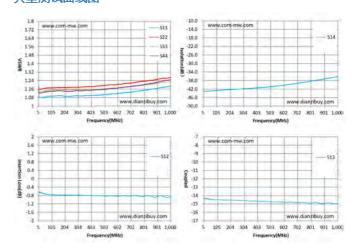
外形结构图 (mm)



Electrical Schematic



典型测试曲线图



注意事项

1	清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持260℃回流焊。

拟制: 0001 22-03-20 审核: 0001 22-03-20 客户: 版本: 220529V2



5~1000MHz, 耦合度20dB, 微带半圆孔, 2W, 工业级, 替代ADC-20-4+

产品特点

宽带,小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	5	~	1000	MHz
插入损耗		0.7	1	dB
耦合度	19	20	21	dB
方向性		10		dB
主线驻波比		1.2	1.35	
耦合线驻波比		1.2	1.35	

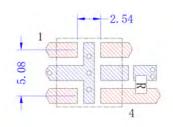
其它参数

接口形式	微带半圆孔	
阻抗	50Ω	
功率容量	2W	
工作温度	-40~+85℃设计保证	
存储温度	-55~+100℃设计保证	
质量等级	工业级	
其它	替代ADC-20-4+	

端口定义

输入端口	1
输出端口	6
耦合端口	3
隔离端口	4 (外接50Ω负载)
接地端口	2

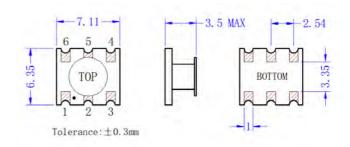
建议PCB布局图

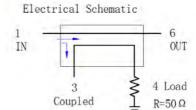


参考实物图



外形结构图 (mm)





注意事项

1	清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持260℃回流焊。



10~512MHz, 双定向耦合度15dB, 微带半圆孔, 1W

产品特点

宽带,大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	10	~	512	MHz
插入损耗			1	dB
双定向耦合度	14.3	15	15.7	dB
方向性	15			dB
主线驻波比			1.3	
耦合线驻波比			1.3	

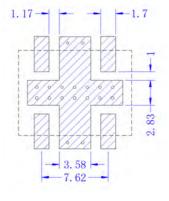
其它参数

接口形式	微带半圆孔
阻抗	50Ω
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+85℃设计保证

端口定义

输入端口	8	1
输出端口	1	8
耦合端口	5	4
隔离端口	4	5
接地端口	2,3,6,7	2,3,6,7

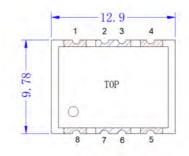
建议PCB布局图

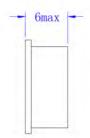


参考实物图

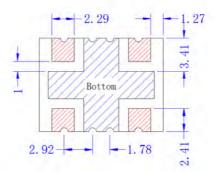


外形结构图 (mm)

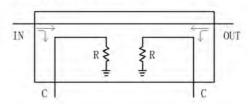




Tolerance: ± 0.3 mm



Electrical Schematic



注意事项

1	清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持220℃回流焊。

拟制: 0001 22-06-12 审核: 0001 22-06-12

客户:

版本: 220612V1

注:本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试;由于产品升级迭代,对与本页内容的任何变更恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。

10~512MHz, 双定向耦合度20dB, 微带半圆孔, 25W, 工业级, 替代SYDC-20-62HP+

产品特点

宽带,大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	10	~	512	MHz
插入损耗		0.2	0.6	dB
双定向耦合度	19	20	21	dB
方向性	16	25		dB
主线驻波比		1.1		
耦合线驻波比		1.1		

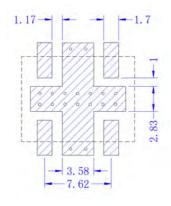
其它参数

接口形式	微带半圆孔	
阻抗	500	
PEDU	3022	
功率容量	25W设计保证	
工作温度	-40~+85°C设计保证	
11	******	
存储温度	-55~+100℃设计保证	
质量等级	工业级	
其它	替代SYDC-20-62HP+	

端口定义

输入端口	8	1
输出端口	1	8
耦合端口	5	4
隔离端口	4	5
接地端口	2,3,6,7	2,3,6,7

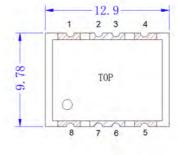
建议PCB布局图

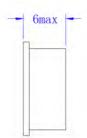


参考实物图

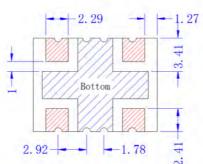


外形结构图 (mm)

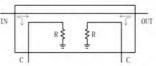




Tolerance: $\pm 0.3 \mathrm{mm}$



Electrical Schematic



注意事项

1	清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持220℃回流焊。

拟制: 0001 22-06-12 审核: 0001 22-06-12

客户:

版本: 220612V2



10~678MHz, 双定向耦合度20dB, 微带半圆孔, 25W

产品特点

宽带,大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	10	~	678	MHz
插入损耗		0.2	0.6	dB
双定向耦合度	19	20	21	dB
方向性	15	18		dB
主线驻波比			1.3	
耦合线驻波比			1.3	

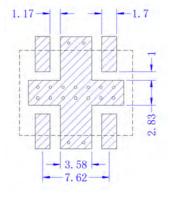
其它参数

接口形式	微带半圆孔
阻抗	50Ω
功率容量	25W设计保证
工作温度	-55~+85°C

端口定义

输入端口	8	1
输出端口	1	8
耦合端口	5	4
隔离端口	4	5
接地端口	2,3,6,7	2,3,6,7

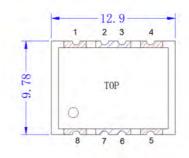
建议PCB布局图

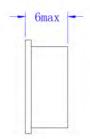


参考实物图

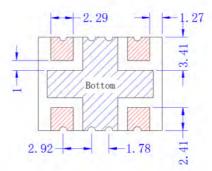


外形结构图 (mm)

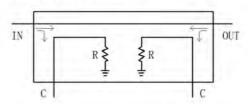




Tolerance: ±0.3mm



Electrical Schematic



注意事项

1	清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190℃回流焊

拟制: 0001 22-06-12 审核: 0001 22-06-12 客户: 版本: 220612V2

注:本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试;由于产品升级迭代,对与本页内容的任何变更恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。



10~1500MHz, 耦合度7dB, 微带半圆孔, 2W, 工业级, 替代DBTC-7-152+

产品特点

宽带,小体积,内置50欧负载。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	10	~ 1500		MHz
插入损耗		2.2	3.2	dB
耦合度	6.5	7	7.5	dB
方向性	9	18		dB
主线驻波比		1.4	1.9	
耦合线驻波比		1.4	1.9	

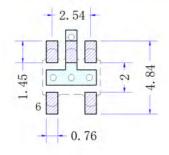
其它参数

接口形式	微带半圆孔
阻抗	50Ω
功率容量	2W
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-55~+100℃设计保证
质量等级	工业级
其它	替代DBTC-7-152+

端口定义

输入端口	3
输出端口	4
耦合端口	1
接地端口	2

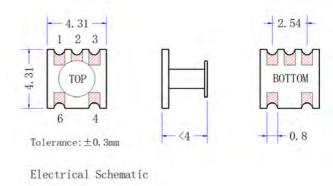
建议PCB布局图

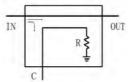


参考实物图



外形结构图 (mm)





注意事项

1	清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。	
2	产品支持260℃回流焊。	

拟制: 0001 22-03-30 审核: 0001 22-03-30 客户: 版本: 220420V3

注:本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试;由于产品升级迭代,对与本页内容的任何变更恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。



20~678MHz, 耦合度50dB, 微带半圆孔, 300W, 工业级, 替代IPP-8044

产品特点

宽带,大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	20	~	678	MHz
插入损耗		0.15	0.3	dB
耦合度	49	50	51	dB
方向性		20		dB
主线驻波比		1.2		
耦合线驻波比		1.1		

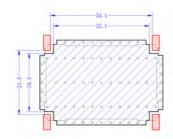
其它参数

接口形式	微带半圆孔
阻抗	50Ω
功率容量	300W
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+100℃设计保证
质量等级	工业级
其它	替代IPP-8044

端口定义

输入端口	1或2
输出端口	2或1
耦合端口	3或4
隔离端口	4或3

建议PCB布局图



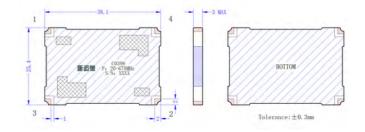
典型测试数据

F(MHz)	S12 IL	S14 ISO	S11 VSW R	S33 VSW R	S13 C
20	-0.01	-95	1.01	1.28	-50.1
100	-0.02	-82.6	1.02	1.22	-49.9
150	-0.04	-86.4	1.03	1.18	-49.7
240	-0.05	-85.4	1.04	1.13	-49.8
320	-0.13	-84.9	1.05	1.12	-50.1
420	-0.14	-77.2	1.07	1.12	-50.2
520	-0.19	-74.2	1.08	1.13	-50.3
600	-0.2	-71.3	1.07	1.14	-50.1
680	-0.23	-69.1	1.07	1.16	-50.1

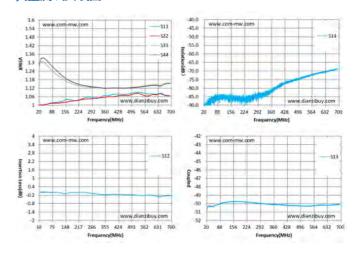
参考实物图



外形结构图 (mm)



典型测试曲线图



注意事项

1	清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持220℃回流焊。



20~1000MHz, 耦合度50dB, 微带半圆孔, 150W, 工业级, 替代IPP-8070

产品特点

宽带,大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	20	~	1000	MHz
插入损耗			0.3	dB
耦合度	48.5	50	51.5	dB
方向性	19	23		dB
主线驻波比		1.1	1.2	
耦合线驻波比		1.2	1.3	

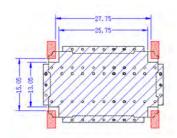
其它参数

接口形式	微带半圆孔
功率容量	150W (200W@20-500MHz; 150W@500-1000MHz)
三阶互调	1@设计保证
工作温度	-40~+85℃设计保证
质量等级	工业级
其它	替代IPP-8070

端口定义

输入端口	1或2
输出端口	2或1
耦合端口	3或4
隔离端口	4或3

建议PCB布局图



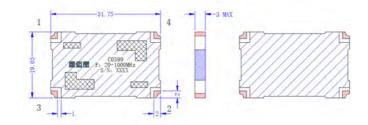
典型测试数据

F(MHz)	S12 IL	S14 ISO	S11 VSW R	S33 VSW R	S13 C
20	-0.01	-68.5	1.01	1.24	-51.1
100	-0.02	-72.5	1.02	1.06	-49.8
300	-0.03	-71.4	1.05	1.12	-49.9
450	-0.07	-75.8	1.04	1.15	-49.8
600	-0.11	-78.2	1.02	1.18	-50.1
700	-0.14	-79.8	1.05	1.21	-50.1
800	-0.17	-77.9	1.09	1.24	-49.9
900	-0.19	-75.1	1.14	1.27	-49.8
1000	-0.21	-72.8	1.18	1.29	-49.8

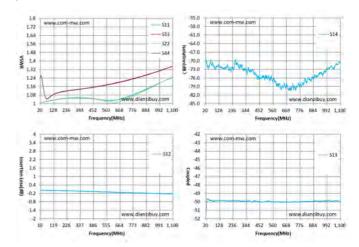
参考实物图



外形结构图 (mm)



典型测试曲线图



注意事项

1	清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持220℃回流焊。

注:本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试;由于产品升级迭代,对与本页内容的任何变更恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。



30~2000MHz, 耦合度20dB, 微带半圆孔, 2W, 工业级

产品特点

宽带,小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	30	~	2000	MHz
插入损耗			1.6	dB
耦合度	18.5	20	21.5	dB
方向性	8			dB
主线驻波比		1.5		
耦合线驻波比		1.5		

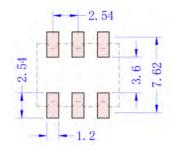
其它参数

接口形式	微带半圆孔
阻抗	50Ω
功率容量	2W设计保证
工作温度	-40~+85℃设计保证
质量等级	工业级

表格标题

输入端口	1	
输出端口	6	
耦合端口	3	
隔离端口	4 (外接50欧电阻)	
接地端口	接地	

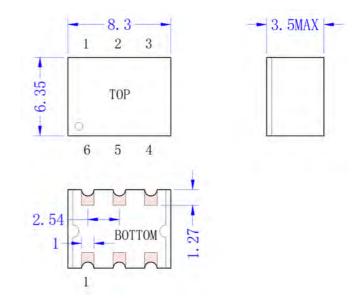
建议PCB布局图



参考实物图



外形结构图 (mm)



注意事项

1	清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持260℃回流焊。

拟制: 0001 22-06-14 审核: 0001 22-06-14 客户: 版本: 220614V1



50~2000MHz, 耦合度17dB, 微带半圆孔, 2W, 工业级, 替代DBTC-17-5+

产品特点

宽带,内置负载。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	50	~	2000	MHz
插入损耗		1.2		dB
耦合度	16	17	18	dB
方向性	6	10		dB
主线驻波比		1.3		
耦合线驻波比		1.3		

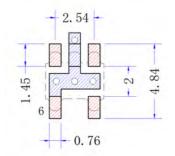
其它参数

接口形式	微带半圆孔
阻抗	50Ω
功率容量	2W
工作温度	-40~+85℃设计保证
质量等级	工业级
其它	替代DBTC-17-5+

端口定义

输入端口	3
输出端口	4
耦合端口	1
隔离端口	2,6

建议PCB布局图



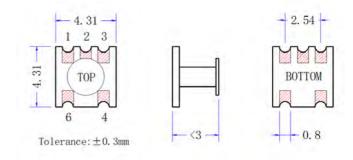
典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S22 驻波	S13 耦合 dB	S12 损耗 dB	S23 隔离 dB
20	1.09	1.15	-16.39	-0.66	-34.69
176	1.07	1.11	-16.37	-0.63	-37.38
487	1.08	1.08	-16.55	-0.68	-28.88
643	1.08	1.05	-16.72	-0.76	-26.66
954	1.09	1.06	-16.77	-0.72	-23.6
1110	1.09	1.09	-16.9	-0.79	-23.9
1421	1.11	1.15	-16.82	-0.92	-24.92
1577	1.14	1.17	-16.88	-0.98	-26.41
1889	1.17	1.2	-16.67	-1.1	-28
2044	1.19	1.23	-16.42	-1.24	-27.15

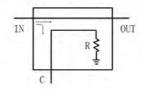
参考实物图



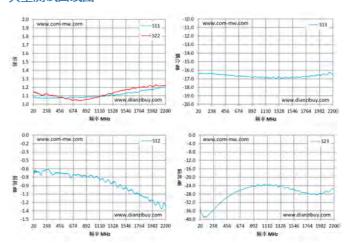
外形结构图 (mm)



Electrical Schematic



典型测试曲线图



注意事项

1	清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持260℃回流焊。

拟制: 0001 22-06-15 审核: 0001 22-06-15 客户: 版本: 220615V2

注:本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试;由于产品升级迭代,对与本页内容的任何变更恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。



100~1200MHz, 耦合度20dB, 微带焊盘, 1W, 工业级, 替代ADC-20-12+

产品特点

宽带,小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	100	~	1200	MHz
插入损耗		0.5	1.1	dB
耦合度	19.2	20	20.8	dB
方向性	13	26		dB
主线驻波比		1.20		
耦合线驻波比		1.2		

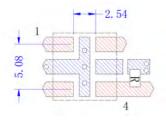
其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	1W
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+100℃设计保证
质量等级	工业级
其它	替代ADC-20-12+

端口定义

输入端口	1
输出端口	6
耦合端口	3
负载端口	4
接地端口	2

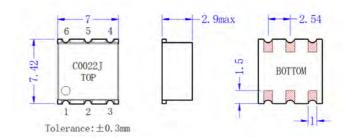
建议PCB布局图

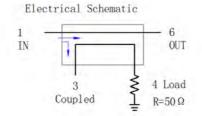


参考实物图



外形结构图 (mm)





注意事项

1	清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持220℃回流焊。

拟制: 0001 22-04-29 审核: 0001 22-04-29 客户: 版本: 220604V2

注:本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试;由于产品升级迭代,对与本页内容的任何变更恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。



200~1000MHz, 耦合度40dB, 微带半圆孔, 300W

产品特点

宽带,大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	200	~	1000	MHz
插入损耗			0.35	dB
耦合度	39	40	41	dB
方向性	20			dB
主线驻波比		1.15	1.25	
耦合线驻波比		1.2	1.3	

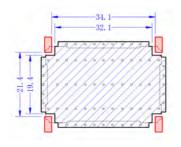
其它参数

接口形式	微带半圆孔
功率容量	300W
三阶互调	1@设计保证
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证

端口定义

输入端口	1或2
输出端口	2或1
耦合端口	3或4
隔离端口	4或3

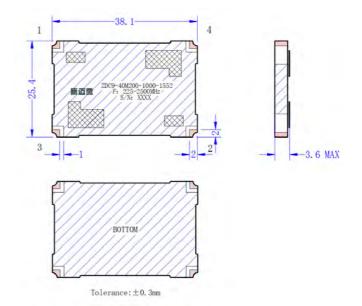
建议PCB布局图



参考实物图



外形结构图 (mm)



注意事项

1	清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持220℃回流焊。

拟制: 0001 22-05-22 审核: 0001 22-05-22 客户: 版本: 220522V1



225~1850MHz, 耦合度35dB, 微带半圆孔, 100W, 工业级, 替代IPP-8059

产品特点

宽带,大功率。

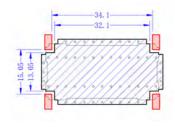
主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	225	~	1850	MHz
插入损耗			0.4	dB
耦合度	33.5	35	36.5	dB
方向性		18		dB
主线驻波比		1.25		
耦合线驻波比		1.35		

其它参数

接口形式	微带半圆孔			
阻抗	50	Ω		
功率容量	100	0W		
工作温度	-40~+85°0	C设计保证		
存储温度	-55~+125℃设计保证			
质量等级	工业级			
其它	替代IPP-8059			
输入端口	1 2			
输出端口	2 1			
耦合端口	3 4			
隔离端口	4	3		

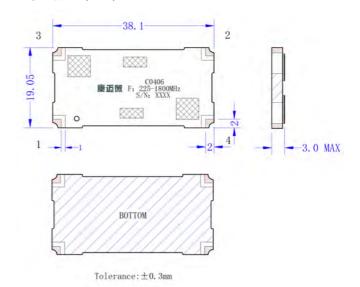
建议PCB布局图



参考实物图



外形结构图 (mm)



注意事项

1	清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持260℃回流焊。

拟制: 0001 22-06-10 审核: 0001 22-06-10 客户: 版本: 220610V1



225~2500MHz, 耦合度45dB, 微带半圆孔, 200W, 工业级, 替代IPP-8063

产品特点

宽带,大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	225	~	2500	MHz
插入损耗			0.25	dB
耦合度	44	45	46	dB
方向性		20		dB
主线驻波比		1.25		
耦合线驻波比		1.35		

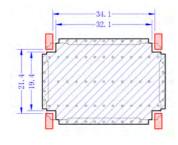
其它参数

接口形式	微带半圆孔
阻抗	50Ω
功率容量	200W
工作温度	-40~+85°C
存储温度	-55~+125°C
质量等级	工业级
其它	替代IPP-8063

端口定义

输入端口	1&2
输出端口	2&1
耦合端口	3&4
隔离端口	4&3

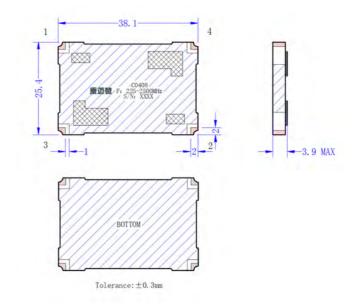
建议PCB布局图



参考实物图



外形结构图 (mm)



注意事项

1	清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持260℃回流焊。



500~2500MHz, 耦合度33dB, 微带半圆孔, 150W, 工业级, 替代IPP-8057

产品特点

宽带,高方向性,大功率。

技术要求

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	500	~	2500	MHz
插入损耗		0.25		dB
耦合度	31.5	33	34.5	dB
方向性		20		dB
驻波比		1.25	1.35	

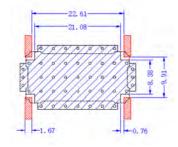
其它参数

接口形式	微带半圆孔
阻抗	50Ω
功率容量	150W
三阶互调	1@设计保证
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级
其它	替代IPP-8057

端口定义

输入端口	1或2
输出端口	2或1
耦合端口	3或4
隔离端口	4或3

建议PCB布局图



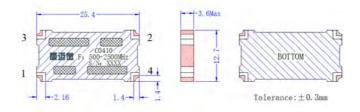
典型测试数据

F(MHz)	S12 IL	S23 ISO	S11 VSW R	S33 VSW R	S13 C
500	-0.06	-66.9	1.07	1.15	-32.8
800	-0.09	-60.3	1.08	1.2	-32.4
1000	-0.11	-56.1	1.05	1.21	-32.7
1200	-0.18	-53.3	1.03	1.14	-32.9
1400	-0.14	-53.5	1.04	1.27	-32.8
1600	-0.19	-52.8	1.07	1.29	-32.3
1900	-0.25	-53	1.15	1.21	-31.5
2200	-0.28	-52.7	1.17	1.22	-31.5
2500	-0.31	-59.9	1.09	1.28	-32.2

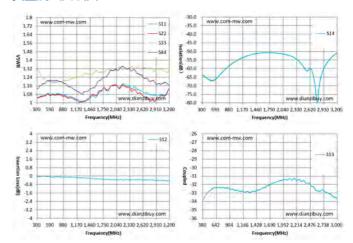
参考实物图



外形结构图 (mm)



典型测试曲线图



注意事项

1	清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持220℃回流焊。
3	上图损耗包含测试夹具损耗,实际2500MHz的损耗可以 小0.2~0.3dB。

拟制: 0001 22-05-11 审核: 0001 22-05-11 客户: 版本: 220609V4

注:本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试;由于产品升级迭代,对与本页内容的任何变更恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。



500~3000MHz, 耦合度32dB, 微带半圆孔, 200W, 工业级, 替代IPP-8090

产品特点

宽带,大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	500	~	3000	MHz
插入损耗		0.3	0.3	dB
耦合度	30.5	32	33.5	dB
方向性		17		dB
主线驻波比		1.3		
耦合线驻波比		1.4		

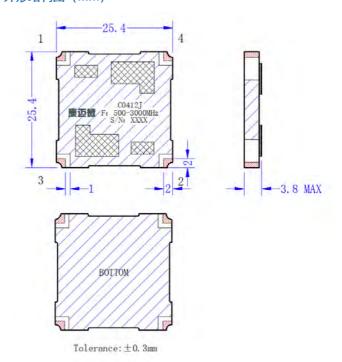
其它参数

接口形式	微带半圆孔
阻抗	50Ω
功率容量	200W
工作温度	-55~+85°C
存储温度	-55~+125°C
质量等级	工业级
其它	替代IPP-8090

端口定义

输入端口	1&2
输出端口	2&1
耦合端口	3&4
隔离端口	4&3

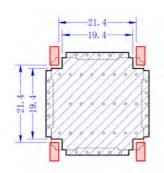
外形结构图 (mm)



注意事项

1	清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持260℃回流焊。

建议PCB布局图





800~1000MHz, 耦合度10dB, 微带半圆孔, 250W, 工业级

产品特点

小体积,大功率。

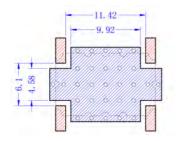
主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	800	~	1000	MHz
插入损耗		0.2		dB
耦合度	9.4	10	10.6	dB
方向性		22		dB
主线驻波比		1.2		
耦合线驻波比		1.2		

其它参数

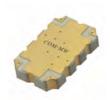
接口形式	微带半圆孔			
阻抗		50Ω		
功率容量	25	0W		
工作温度	-55~+85°	C设计保证		
存储温度	-55~+100℃设计保证			
质量等级	工业级			
其它	替代XC0900A-10S			
输入端口	1 2			
输出端口	2 1			
耦合端口	4 3			
隔离端口	3 4			

建议PCB布局图

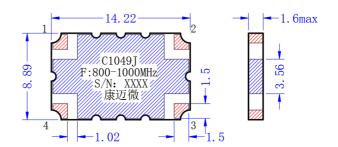


官网 www.com-mw.com

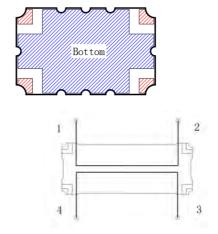
参考实物图



外形结构图 (mm)



Tolerance: ± 0.3 mm



注意事项

1	清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持260℃回流焊。

拟制: 0001 22-06-14 审核: 0001 22-06-14 客户: 版本: 220614V1

电话 15608095669

800~1000MHz, 耦合度20dB, 微带半圆孔, 150W, 工业级, 替代XC0900A-

产品特点

小体积,大功率。

主要参数

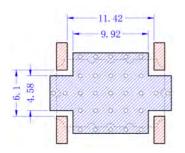
参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	800	~	1000	MHz
插入损耗		0.25		dB
耦合度	19.2	20	20.8	dB
方向性		20		dB
主线驻波比		1.2		
耦合线驻波比		1.2		

其它参数

接口形式	沙带	上回习		
		微带半圆孔		
阻抗	50	Ω		
功率容量	15	0W		
工作温度	-55~+85°(C设计保证		
存储温度	-55~+100℃设计保证			
质量等级	工业级			
其它	替代XC0900A-20S			
输入端口	1 2			
输出端口	2 1			
耦合端口	4 3			
隔离端口	3 4			

建议PCB布局图

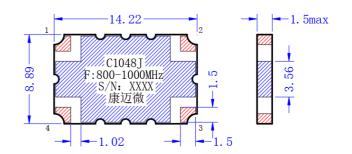
官网 www.com-mw.com



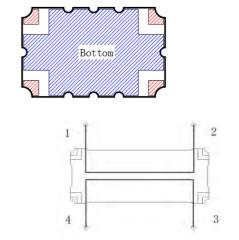
参考实物图



外形结构图 (mm)



Tolerance: $\pm 0.3 mm$



注意事项

1	清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持260℃回流焊。

拟制: 0001 22-06-14 审核: 0001 22-06-14 客户: 版本: 220614V1

电话 15608095669

800~3000MHz, 耦合度25dB, 微带半圆孔, 150W, 工业级, 代替BDCH-25-

33+

产品特点

宽带,大功率。

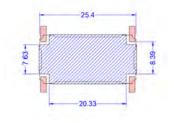
主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	800	~	3000	MHz
插入损耗		0.2	0.3	dB
耦合度	24	25	26	dB
方向性	21	28		dB
主线驻波比		1.1		
耦合线驻波比		1.2		

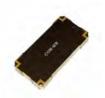
其它参数

接口形式	微带半圆孔		
阻抗	50	Ω	
功率容量	15	0W	
工作温度	-40~-	+85°C	
存储温度	-55~+100°C		
质量等级	工业级		
其它	代替BDCH-25-33+		
输入端口	1 2		
输出端口	2 1		
耦合端口	4 3		
隔离端口	3 4		

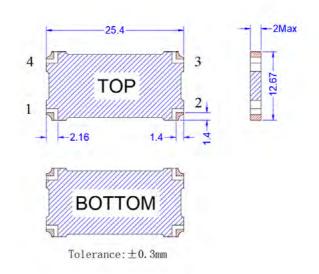
建议PCB布局图

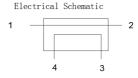


参考实物图



外形结构图 (mm)





注意事项

1	清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持220℃回流焊。

拟制: 0001 22-05-11 审核: 0001 22-05-11 客户: 版本: 220609V1

1700~2000MHz, 耦合度10dB, 微带半圆孔, 175W, 工业级, 替代 XC1900A-10S

产品特点

小体积,大功率。

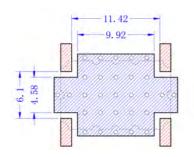
主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1700	~	2000	MHz
插入损耗		0.25		dB
耦合度	9.4	10	10.6	dB
方向性		20		dB
主线驻波比		1.2		
耦合线驻波比		1.2		

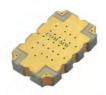
其它参数

接口形式	微带半圆孔		
阻抗	50Ω		
功率容量	175W		
工作温度	-55~+85°0	C设计保证	
存储温度	-55~+100℃设计保证		
质量等级	工业级		
其它	替代XC1900A-10S		
输入端口	1 2		
输出端口	2 1		
耦合端口	4 3		
隔离端口	3 4		

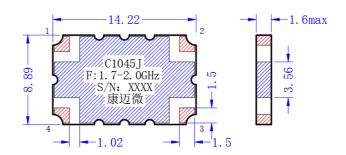
建议PCB布局图



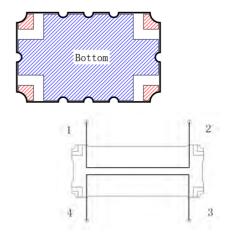
参考实物图



外形结构图 (mm)



Tolerance: ± 0.3 mm



注意事项

1	清冼产品表面,请勿将产品浸泡清冼液中清洗。
2	产品支持260℃回流焊。

1700~2000MHz, 耦合度20dB, 微带半圆孔, 150W, 工业级, 替代 XC1900A-20S

产品特点

小体积,大功率。

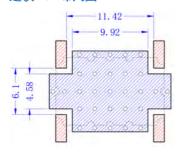
主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1700	~	2000	MHz
插入损耗		0.2		dB
耦合度	19.2	20	20.8	dB
方向性		20		dB
主线驻波比		1.25		
耦合线驻波比		1.25		

其它参数

接口形式	微带半圆孔			
阻抗	50Ω			
功率容量	150W			
工作温度	-55~+85°	-55~+85℃设计保证		
存储温度	-55~+100℃设计保证			
质量等级	工业级			
其它	替代XC1900A-20S			
输入端口	1	2		
输出端口	2 1			
耦合端口	4 3			
隔离端口	3 4			

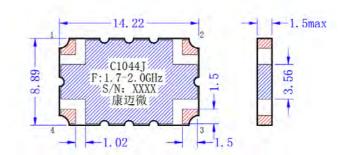
建议PCB布局图



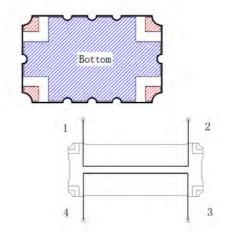
参考实物图



外形结构图 (mm)



Tolerance: \pm 0.3mm



注意事项

1	清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持260℃回流焊。

电话 15608095669

2000~2300MHz, 耦合度10dB, 微带半圆孔, 165W, 工业级, 替代 XC2500E-10S

产品特点

小体积,大功率。

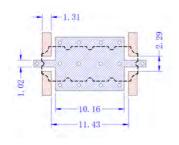
主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	2000	~	2300	MHz
插入损耗		0.2		dB
耦合度	9.4	10	10.6	dB
方向性		20		dB
主线驻波比		1.2		
耦合线驻波比		1.2		

其它参数

接口形式	為井上	半圆孔 ,		
阻抗	50	Ω		
功率容量	16	165W		
工作温度	-55~+85°0	C设计保证		
存储温度	-55~+100℃设计保证			
质量等级	工业级			
其它	替代XC2500E-10S			
输入端口	1 2			
输出端口	2 1			
耦合端口	4 3			
隔离端口	3 4			

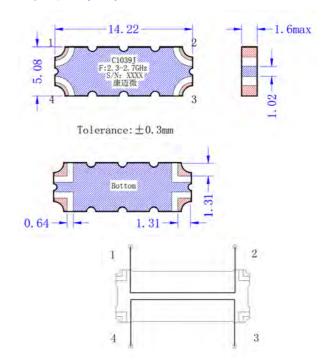
建议PCB布局图



参考实物图



外形结构图 (mm)



注意事项

1	清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持260℃回流焊。

拟制: 0001 22-06-14 审核: 0001 22-06-14 客户: 版本: 220614V1

2000~2300MHz, 耦合度30dB, 微带半圆孔, 120W, 工业级, 替代 XC2100A-30S

产品特点

小体积,大功率。

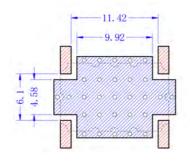
主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	2000	~	2300	MHz
插入损耗		0.2		dB
耦合度	29.2	30	30.8	dB
方向性		18		dB
主线驻波比		1.25		
耦合线驻波比		1.25		

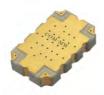
其它参数

接口形式	微带半圆孔		
阻抗	50Ω		
功率容量	120W		
工作温度	-55~+85°(C设计保证	
存储温度	-55~+100℃设计保证		
质量等级	工业级		
其它	替代XC2100A-30S		
输入端口	1	2	
输出端口	2 1		
耦合端口	4 3		
隔离端口	3 4		

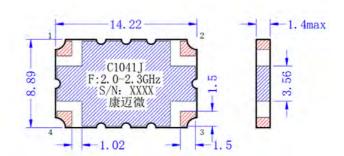
建议PCB布局图



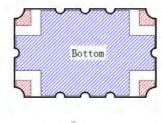
参考实物图

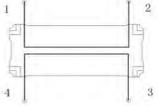


外形结构图 (mm)



Tolerance: ±0.3mm





注意事项

1	清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持260℃回流焊。

拟制: 0001 22-06-14 审核: 0001 22-06-14 客户: 版本: 220614V2

2300~2700MHz, 耦合度10dB, 微带半圆孔, 145W, 工业级, 替代 XC2500E-10S

产品特点

小体积,大功率。

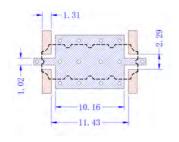
主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	2300	~	2700	MHz
插入损耗		0.3		dB
耦合度	9.4	10	10.6	dB
方向性		20		dB
主线驻波比		1.2		
耦合线驻波比		1.2		

其它参数

接口形式	微带半圆孔		
阻抗	50	JΩ	
功率容量	14	5W	
工作温度	-55~+85°0	C设计保证	
存储温度	-55~+100℃设计保证		
质量等级	工业级		
其它	替代XC2500E-10S		
输入端口	1	2	
输出端口	2	1	
耦合端口	4	3	
隔离端口	3	4	

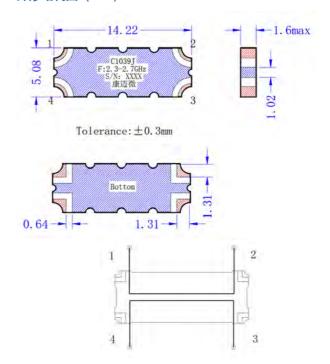
建议PCB布局图



参考实物图



外形结构图 (mm)



注意事项

1	清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持260℃回流焊。

拟制: 0001 22-06-14 审核: 0001 22-06-14 客户: 版本: 220614V1

2300~2700MHz, 耦合度20dB, 微带半圆孔, 50W, 普军级, 替代XC2500P-

20S

产品特点

大功率,小体积。

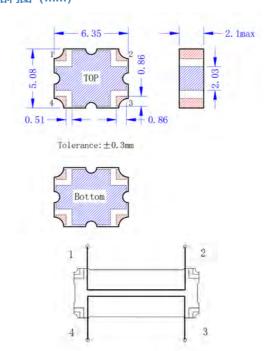
主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	2300	~	2700	MHz
插入损耗		0.2		dB
耦合度	19	20	21	dB
方向性		20		dB
主线驻波比		1.2		
耦合线驻波比		1.2		

其它参数

接口形式	微带半圆孔		
阻抗	50	Ω	
功率容量	50	W	
工作温度	-55~+	+85°C	
存储温度	-55~+100°C		
质量等级	普军级		
其它	替代XC2500P-20S		
输入端口	1 2		
输出端口	2	1	
耦合端口	4	3	
隔离端口	3 4		

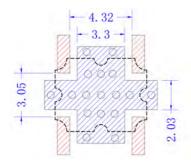
外形结构图 (mm)



注意事项

1	清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持220℃回流焊。

建议PCB布局图



2300~3800MHz, 耦合度20dB, 微带半圆孔, 25W, 工业级, 替代X3C30F1-

20S

产品特点

宽带,大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	2300	~	3800	MHz
插入损耗		0.15		dB
耦合度	18.5	20	21.5	dB
方向性		20		dB
主线驻波比		1.22		

其它参数

接口形式	微带半圆孔		
阻抗	50Ω		
功率容量	25W		
工作温度	-40~+85℃设计保证		
存储温度	-55~+100°C设计保证		
质量等级	工业级		
其它	替代X3C30F1-20S		

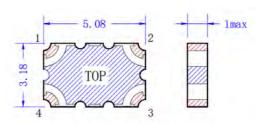
端口定义

输入端口	1	2
输出端口	2	1
耦合端口	4	3
隔离端口	3	4

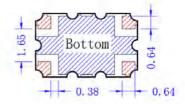
参考实物图



外形结构图 (mm)



Tolerance: ±0.3mm



注意事项

1	清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持260℃回流焊。

拟制: 0001 22-06-12 审核: 0001 22-06-12 客户: 版本: 220612V1

3300~3800MHz, 耦合度20dB, 微带半圆孔, 80W, 工业级, 替代XC3500M-

产品特点

宽带,大功率。

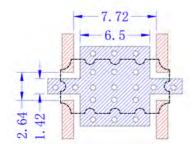
主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	3300	~	3800	MHz
插入损耗		0.3		dB
耦合度	19	20	21	dB
方向性		18		dB
主线驻波比		1.25		
耦合线驻波比		1.25		

其它参数

接口形式	微带半圆孔		
阻抗	50	Ω	
功率容量	80	W	
工作温度	-55~+85°0	C设计保证	
存储温度	-55~+100℃设计保证		
质量等级	工业级		
其它	替代XC3500M-20S		
输入端口	1	2	
输出端口	2	1	
耦合端口	4	3	
隔离端口	3	4	

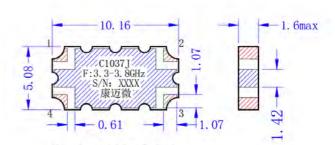
建议PCB布局图



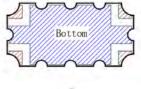
参考实物图

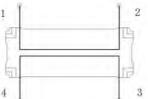


外形结构图 (mm)



Tolerance: ±0.3mm





注意事项

1	清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持260℃回流焊。